



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23740X

Issue Date: 28 Dec 2020

Title of Change:	Initial PCN for adding ON Semiconductor Aizu to Back Grind, Back Metal and Laser Marking manufacturing site.	
Proposed First Ship date:	20 Dec 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Osamu.Akaki@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	New location code for ON Semiconductor Aizu is "JA".	
Change Category:	Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Aizu, Japan	None	
Description and Purpose:		
This Initial Product/Process Change Notification (IPCN) announces the adding ON Semiconductor Aizu to Back Grind, Back Metal and Laser Marking manufacturing site.		
Frontend process, assembly and final test process are not changed.		
	Before Change Description	After Change Description
Back Grind	ON Semiconductor Niigata	ON Semiconductor Niigata and ON Semiconductor Aizu
Back Metal	ON Semiconductor Niigata	ON Semiconductor Niigata and ON Semiconductor Aizu
Laser Marking	ON Semiconductor Niigata	ON Semiconductor Niigata and ON Semiconductor Aizu
	From	To
Product marking change Location Code	ON Semiconductor Niigata : Z	ON Semiconductor Niigata : Z and ON Semiconductor Aizu : JA

**Qualification Plan:**QV DEVICE NAME EFC4K110NUZTDG and EFC2K112NUZTDGPACKAGE: WLCSP

Test	Specification	Condition	Interval
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1,000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs

Estimated date for qualification completion: 13 August 2021

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
EFC2K101NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K102NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K103NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K107NUZTCG	EFC4K110NUZTDG
EFC4K110NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K112NUZTDG	EFC2K112NUZTDG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN23740X

発行日 : 28 Dec 2020

変更件名:	バックグラインド、バックメタル、レーザーマーキングの製造拠点としてオン・セミコンダクター会津追加のための初回 PCN
初回出荷予定日:	20 Dec 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Osamu.Akaki@onsemi.com > にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	オン・セミコンダクター会津の新しいロケーションコードは「JA」です。
変更カテゴリ:	ウェアファブの変更
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加
影響を受ける拠点: w	
外部製造工場 / 下請業者拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
ON Semiconductor Aizu, Japan	なし

説明および目的:

この初回製品/プロセス変更通知 (IPCN) は、バックグラインド、バックメタル、レーザーマーキングの製造拠点としてオン・セミコンダクター会津を追加することをお知らせするものです。

フロントエンド工程、組立および最終検査工程に変更はありません。

	変更前の表記	変更後の表記
バックグラインド	オン・セミコンダクター新潟	オン・セミコンダクター新潟およびオン・セミコンダクター会津
バックメタル	オン・セミコンダクター新潟	オン・セミコンダクター新潟およびオン・セミコンダクター会津
レーザーマーキング	オン・セミコンダクター新潟	オン・セミコンダクター新潟およびオン・セミコンダクター会津

	変更前	変更後
製品マーキングの変更 ロケーションコード	オン・セミコンダクター新潟 : Z	オン・セミコンダクター新潟 : Z および オン・セミコンダクター会津 : JA

初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23740X

発行日 : 28 Dec 2020

認定計画:

デバイス名 : EFC4K110NUZTDG and EFC2K112NUZTDG

パッケージ : WLCSP

テスト	規格	条件	間隔
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1,000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs

認定完了予定日 : 13 August 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
EFC2K101NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K102NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K103NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K107NUZTCG	EFC4K110NUZTDG
EFC4K110NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
EFC2K112NUZTDG	EFC2K112NUZTDG